

证券代码：300476

证券简称：胜宏科技

胜宏科技(惠州)股份有限公司投资者关系活动记录表

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（深圳证券交易所举办“走进成份股公司-胜宏科技”活动） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 深交所、大成基金、广发证券及 28 位个人投资者 |
| 时间 | 2026年07月01日 |
| 地点 | 惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技（惠州）股份有限公司 |
| 上市公司接待人员姓名 | 1、资本市场部总监：周明达 2、投资者关系专员：汤佳怡 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、投资者参观公司展厅、生产车间</p> <p>二、公司发展情况介绍</p> <p>1、AI 带来的行业机遇</p> <p>AI 工业革命的兴起，推动算力相关下游领域高速发展。未来五年，在人工智能的引领下，服务器/数据储存、网络通信、汽车电子等下游行业需求将持续增长，带动高多层板、HDI 板保持较高增长。根据 PrismaMark 数据，AI 服务器相关 PCB 市场 2024—2029 年年均复合增速将达到 18.7%；其中，AI 服务器相关 HDI 的年均复合增速为 29.6%，AI 相关 18 层及以上多层板年均复合增长率为 33.8%，远远超过 PCB 行业平均增速。</p> |

公司坚定“拥抱 AI，奔向未来”，精准把握 AI 算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历史新机遇，持续巩固在全球 PCB 制造领域的技术领先地位。在 AI 算力、数据中心、高性能计算等关键领域，多款高端产品已实现大规模量产，带动产品结构向高价值量、高技术复杂度方向升级，高端产品占比显著提升，推动公司业绩高速增长。

2、公司领先优势

(1) 战略优势

公司坚定“拥抱 AI，奔向未来”的核心发展理念，紧抓 AI 算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的历史新机遇，成功抢占市场先机。未来，公司将继续紧密围绕客户进行技术创新与产品布局，与客户共成长，把握未来技术和产品风向，为客户提供更优的技术和更好的品质服务，不断提升核心竞争力。

(2) 技术优势

公司凭借研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，深度参与核心客户项目合作研发，提前迈入专有技术积累关键期。公司具备 100 层以上高多层 PCB、10 阶 30 层 HDI 与 16 层任意互联(Any-layer)HDI 的技术能力，并积极推进下一代 14 阶 36 层 HDI 的研发认证；公司的 AI 算力卡、AI Data Center UBB& 交换机市场份额全球领先。

(3) 品质优势

公司产品稳定、可靠性强，高阶 HDI 及高多层良率均为行业较高水平。AI 技术在全流程各检测站分别实现全覆盖，可自动判别、自动筛选、自动统计、自动分析，确保不良品零流出。通过 AI 历史数据建档，精准分析高频问题发生环节，推动产品不良持续改善，实现零缺陷生

产目标。

(4) 产能优势

公司现有产能涵盖广东、湖南、泰国、马来西亚等多个地区，其中，惠州总部已成为全球规模最大的单体 PCB 生产基地，全球化交付、服务能力行业领先。未来，随着惠州工厂、泰国工厂、越南工厂和马来西亚工厂等项目陆续投产爬坡，公司的高端产品产能将进一步提高，能够更好地满足客户全球化交付需求。

(5) 客户优势

凭借领先的研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，深度参与国际头部大客户新产品预研，提前 2-3 年开展相关技术开发储备，从产品规划到技术能力提升，再到扩产计划，全程跟踪服务客户，已形成较强的技术壁垒与客户粘性，市场竞争力强劲，构建了深厚的护城河。

(6) 管理层及文化优势

公司创始人兼董事长陈涛先生是 PCB 行业公认的技术专家和领导者，带领公司精准把握产业趋势，深挖下游行业需求迭代趋势，推动公司高速发展。在董事长的带领下，公司组建了一支具备强大技术专长，经验丰富，兼具国际视野的高级管理团队。同时，公司坚持人才驱动战略，构建全球化人才引进与培养体系，围绕 AI 算力等核心领域定向引进高端管理及技术人才。

3、下游供需格局

从整个供需结构上看，行业对高端产能的需求持续增加，高端产品的供给仍然处于相对紧张的状态。公司同时在研发方面进行多客户的适配，这一适配有利于公司未来进行客户和订单的选择，公司会考虑订单规模、确定性程

度、盈利能力等因素进行产能分配。

4、PCB 未来发展趋势

在 AI 领域，随着算力需求持续提升，行业发展趋势是不断降低单位算力能耗、提升算力密度和电性能能力，具体体现为：信号传输带宽持续升级，材料等级不断提高；高多层板、高阶 HDI 的层数、阶数不断增加，板厚进一步增厚，电路密度也更精细。

这些变化对 PCB 制造工艺要求大幅提高，部分工序的加工时间更长、复杂度更高，加大了对公司高端产能的消耗。同时也使得产值提升，ASP 发生成倍甚至呈指数级别的增长。

三、互动交流环节具体情况如下：

1、公司对于未来高端PCB产能和价格战略上有什么规划？

答：公司正在全力以赴推进扩产，稳步推进 2030 年千亿产值目标落地。从产品规格看，公司将锚定 AI、数据中心交换机等高价值量产品，持续推进产品结构优化及价值量提升。

国内产能方面，惠州厂房四项目现已分阶段逐步投产，目前处于爬坡与量产阶段。公司厂房十、十一目前正在加快建设，今年下半年将持续推进两座工厂的装修、设备安装与调试试产工作。海外产能方面，公司泰国工厂 A1 栋一期升级改造已于 2025 年 3 月完成，二期高端产能已经开始生产验证板；泰国 A2 栋厂房和越南工厂的建设也正在按计划有序推进中。

2、公司说高端产能建设时间较长，具体卡点在哪？

答：新建厂房需经历厂房建设装修、设备安装调试、客户审厂、送样测试、订单下达及量增等阶段，初期的产线磨合和产能产量逐步释放是行业的必经过程。从时间进度来看，国内工厂的建设与设备安装调试大约需要 1 年时间准备，海外工厂则需要更长时间。

公司在基建、装修、设备配置及人才储备等多方面提前进行规划准备，当前各环节进度顺利。

新建工厂完成投产后，良率整体提升速度相对较快，主要得益于公司已具备成熟、稳定的生产工艺体系与质量管控标准，并采用成熟可靠的技术方案与设备配置。同时，公司派驻经验丰富的工艺及生产工程师、管理团队进驻新工厂，快速将成熟生产经验复制到新产线；原有的成熟产线也提前培养储备人员，承接已有项目。以此有效缩短良率爬坡周期，尽快实现稳定量产与目标良率水平。

3、公司上游涨价有向客户传导吗？消费类等中低端产品提价也顺利吗？

答：公司原材料价格波动主要体现在消费类产品上，公司消费业务相对稳定，已将原材料上涨带来的成本压力合理、有序地向下游客户传导。

公司前期量产高端产品原材料价格平稳，产品定价较为稳定，新产品定价遵循市场化定价原则，将根据具体产品料号的制造难度、市场供需、原材料价格波动情况等与客户协商定价。一方面公司将通过优化供应链管理、技术创新及精细化运营等多种措施，积极对冲成本波动影响，另一方面公司快速推进与下游客户议价工作，目前 PCB 产能相对紧张，公司亦优先保障高品质、高价值量客户的产品交付。

价格由供需决定，从中期来看，高端产品的供给仍将处于相对紧张的状态。高端 PCB 产能扩张周期长、设备与工艺壁垒高，新增扩产项目短期难以形成有效产能供给。现阶段下游头部客户以确保供应链稳定、保障产品品质与交付为核心诉求。

4、如何看待公司后续毛利率等盈利能力的变化？

答：公司未来盈利能力有望保持平稳健康发展。一方面，随着高附加值、高毛利产品占比持续提升，产品结构不断优化，将对公司盈利能力形成持续的正向贡献；另一方面，公司短期盈利能力也会受到阶段性因素影响，例如公司为支撑长期发展与产能扩张带来的人员规模快速增长、研发项目持续投入、新建产线相关费用等阶段性支出的影响。

从人员情况来看，公司员工数量从 2024 年底的 1.3 万余人增长至 2025 年底接近 1.8 万人，主要是为未来产能释放与业务扩张提前进行人才储备。从研发情况来看，公司持续加大研发投入力度，聚焦核心产品技术升级、新工艺开发及新产品产业化落地，进一步提升自主研发能力与核心技术壁垒，为公司产能扩张、产品结构优化及长期可持续发展提供坚实技术支撑。

5、公司已有产线比较饱满，后续还有新的产能、产值释放吗？是否有明确投产时间？

答：公司现有产线当前在手订单饱满，业务进展顺利，后续产值增长主要来自两大维度：一是已有产线通过产品结构升级实现产值提升，二是新建的产能持续爬坡带来增量。

| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>已有产线方面，公司聚焦国内外核心算力客户的高端产品，推进 AI 服务器相关高阶 HDI、高多层板、光模块 PCB 等高价值量、高技术复杂度产品的生产，优化产品结构。</p> <p>新建产能层面，公司积极推动国内外的产能扩张进程。国内惠州厂房四项目现已分阶段逐步投产，目前处于爬坡与量产阶段，厂房十、十一目前正在加快建设，除在建厂房外，后续将依照头部 AI 算力及交换机客户需求计划新产能。海外端持续推进泰国、越南及马来西亚的生产基地建设，满足海外客户本地化生产要求。项目建设节奏将根据下游市场需求、设备交付进度、客户订单落地情况有序推进，持续保障超高多层、高阶 HDI、mSAP 等核心产品产能供给，支撑公司长期业务增长。</p> <p>项目建设节奏将根据下游市场需求、设备交付进度、客户订单落地情况有序推进，具体进度请以公司后续披露信息为准。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p> |
| <p>附件清单（如有）</p> | <p>无</p> |
| <p>日期</p> | <p>2026年07月01日</p> |